

高精度覆晶熱壓鍵合設備

隨著半導體行業快速向小型化和高精度發展，Toray Engineering提供獨特和領先技術的解決方案，產品陣容含括於 TSV 3D貼裝、FOWLP、光學設備和其他用途的各種鍵合機，並專注在處理 3D封裝的各種程序中堆疊應用，如用於 CUF、NCP、NCF、Cu Pillars、TSV晶片堆疊等各種製程。



FC3000L2
Chip On Substrate



FC3000WL
Chip On Wafer

產品特徵

- 可處理6~12英吋晶圓(FC3000W系列) 或 95x250mm 基板(FC3000L系列)
- 獨特的陶瓷加熱器，加熱穩定
- 壓力和位置的控制壓力和高度曲線設置
- 高精度定位和高剛性框架，能夠實現高精準定位
- 憑藉其獨特的間隙控制功能，能夠實現最合適的高度控制
- 可更換低壓或高壓之壓合機構，以適用於不同產品設計

產品優勢

- 1.5 μm (3σ) 高精度定位
- 快速升溫加熱器 (200°C/sec @ $\square 22\text{mm}$)
- 壓合高度可控制，適用 C4 及 Cu pillar 製程
- 最高 490N 壓合力，適用高密度多引腳晶片

